

# The new SIPLACE TX micron

高密度システム・イン・パッケージ、IoTモジュール、ウェアラブル、およびサブモジュールでは、大量生産の環境で最高レベルの実装精度が要求されます。

SIPLACE TX micronプラットフォームは、クラス最高レベルの実装精度を達成し、コンパクトで拡張性の高い実装機で大量生産において生産量を最大化するために開発されました。



ますます高まるモビリティへの要求と未来の「コネクテッドワールド」においては、実装精度やスループットの高さ、繊細な部品を扱うことを組み合わせた能力がコンパクトな実装プラットフォームで求められます。

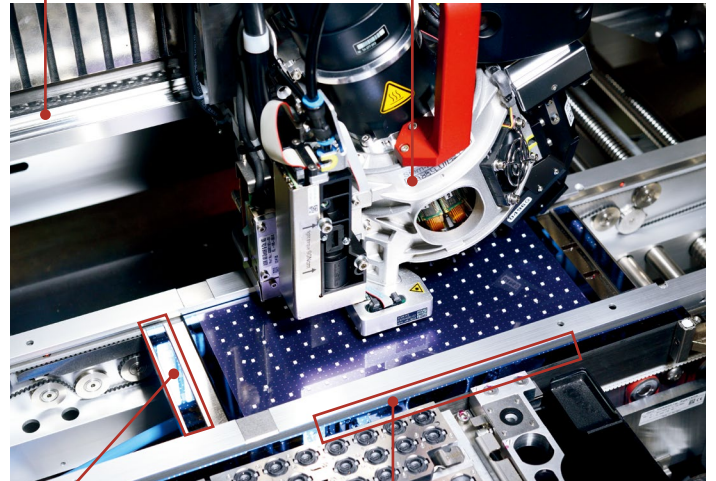
新しい革新的な SIPLACE TX micronは電子機器製造業界やパッケージング業界の要求を満たしています。

高解像度ガラススケールやガントリ動作のためのガラスセラミックフィデューシャル、フラックスやペースト、またはエポキシへの実装における精密なプロセス制御のための「タッチレス実装」モードを装備しつつ、SIPLACE TX micronは実装性能および面積あたりの生産性の観点において新しいベンチマークを達成しました。

## 高精度パッケージ

高解像度ガラススケール

SIPLACE SpeedStar  
CP20 M2\*  
高解像度スケール付



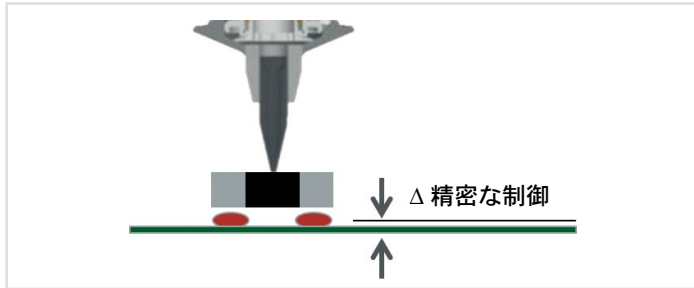
追加フィデューシャルバー  
-Y軸 (15μmのみ)

低膨張ガラスフィデューシャルバー  
-X軸

## 主な特徴：

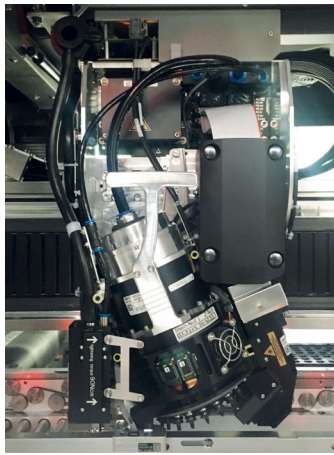
- 最大78,000 cph (ベンチマーク) による高いスループットと単位面積あたりの生産性
- 高密度実装基板やアドバンスパッケージアプリケーションの実装に対応する高い精度 (最小15 μm@3σ)
- スループットへの影響を最低限におさえるため各部品ごとに要求される精度を選択可能
- プログラムで設定可能な低圧力実装 (0.5 N) および壊れやすく繊細な部品に適した「タッチレス実装」
- 集中管理された実装プログラム作成および管理により実装機に簡単にレシピをダウンロード
- 生産性および運用効率を高めるのをサポートする革新的な SIPLACEソフトウェアポートフォリオ

\* SIPLACE MultiStar CPP Mも対応可能

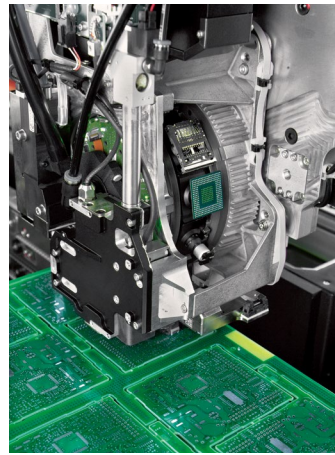


### 「タッチレス装着」- SIPLACE のユニークな新機能

ベアダイなどの壊れやすい部品も、SIPLACE SpeedStar CP20実装ヘッドが精密に制御し、0(ゼロ)Nの力を用いて正確に実装します。



SIPLACE SpeedStar:  
最高レベルのパフォーマンス



SIPLACE MultiStar:  
最高レベルのフレキシビリティ

### モジュールアセンブリの要求を満たす2つのヘッド

SIPLACE SpeedStar CP20は高速なピック&プレースヘッドとして、非常に高い性能と精度を維持しながら0201(mm)の小さい部品に対応します。

SIPLACE MultiStar CPPは、そのユニークな3つの異なる実装モードによって幅広い範囲の部品をカバーします

SIPLACE TX micron		
実装速度 (ベンチマーク)	最大78,000 cph	
実装精度@3シグマ	最小20 $\mu$ m	最小15 $\mu$ m
PCB寸法 (L x W)	デュアル : 50 mm x 45 mm ~ 375 mm x 260 mm シングル : 50 mm x 45 mm ~ 375 mm x 430 mm	50 mm x 55 mm ~ 250 mm x 100 mm
マシン寸法 (L x W x H)	1.00 m x 2.23 m x 1.45 m	
フィーダースロット	最大80 x 8mm、JEDECトレイ	
消費電力	1.9 kW	
エア消費量	120 NI/min (2 x SIPLACE Speedstar)	
認定	Semi S2/S8、クリーンルームクラスISO7	
接続インターフェース	IHERMES (PC-HERMES-9852), SMEMA (IPC-CFX, IPC-SNEMA-9851)	

搭載可能ヘッド		
実装ヘッド	SIPLACE SpeedStar CP20 M	SIPLACE MultiStar CPP M
実装速度 (ベンチマーク)	39,000 cph	24,000 cph
部品範囲	0.12 x 0.12 mm ~ 6 x 6 mm	0.11 x 0.11 mm ~ 15 x 15 mm
最小リード間隔	80/50* $\mu$ m	120 $\mu$ m
最小リード幅	30/25* $\mu$ m	50 $\mu$ m
最小ボール間隔	100/50* $\mu$ m	140 $\mu$ m
最小ボール径	50/25* $\mu$ m	70 $\mu$ m

\* 高解像度カメラ (SST49) 青色LED使用

## エー・エス・エム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社

〒190-0022 東京都立川市錦町 1-7-18 立川エフビル 5階 | 電話 : 042 521 7751 | ファックス : 042 521 7750  
Eメール : [smt-solutions.jp@asmpt.com](mailto:smt-solutions.jp@asmpt.com) | [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)

本パンフレットには、特定の製品には適用されない、もしくは新しい製品開発の結果変更される可能性のある概要および/または機能説明が記載されています。特定の性能および/または能力に関する保証については契約的合意が結ばれている場合にのみ拘束力を発揮します。 | A10011-ASM-G175-JA Edition 04-11/2018